No. IS-11501-006 製品仕様書/Product Specification 来歷 頁/Page 1/8 制定年月日/ISSUUED DATE 標題: 11501 シリーズ 0.5 mmピッチ FPC/FFC コネクタ (NON-ZIF) 2015 - 6 - 23 SUBJECT: Series 11501 0.5mm Pitch FPC/FFC Connector(NON-ZIF) 改訂年月日/REVISED DATE

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 11501 シリーズ 0.5 mmピッチ FPC/FFC コネクタに関する仕様及び 性能上の必要事項について規定する。

(顧客名:車載系各社)

構造及び寸法

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図による。 適用ソケット: IMSA-11501S-***-GFN1

3. 定格

(1)最大定格電圧

50V (AC, DC)

(2)最大定格電流

0.5A-40~+105°C

(3)使用温度範囲

(通電による温度上昇含む)

4. 試験環境

特に規定のある場合を除き、性能試験は、下記の試験条件の もとで行う。

常温

15~35℃

常 湿 25~85% (相対湿度)

5-1. 電気的性能

1. Scope

This product specification is applied to IRISO ELECTRONICS CO., LTD. Series 11501 0.5mm Pitch FPC/FFC Connector. (CUSTOMER NAME: AUTOMOTIVE EACH COMPANY)

2. Configuration, dimensions and materials

See the product drawing attached.

Applied for socket: IMSA-11501S-***-GFN1

3. Rating

(1) Maximum rating voltage: 50 V (AC, DC)

(2) Maximum rating current: 0.5A

(3)Temperature range : -40~+105℃

(Rise in heat is included)

4. Performances

All performance tests, unless otherwise specified, are taken under following environmental conditions.

Ambient temperature: 15~35℃

Ambient humidity :25~85%RH

5. Performance

5-1.Electrical performance

	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初 期 値:40mΩ以下
	Contact Resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:80mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows;	Initial: 40 m Ω or below.
		1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test: $80 \text{m} \Omega$ or below.
2	耐電圧	隣接する極間にAC250V を1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 250V shall be applied for one minute to between next terminals.	Should not have any changes.
	Withstanding		
	Voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC500V を印加する。	初期値:50MΩ以上
	Insulation	DC 500V shall be applied to between next terminals.	耐湿試験後:50MΩ以上
	resistance		Initial: $50M\Omega$ or more
			After humidity test: $50M\Omega$ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ変形、
	Appearance	Visual	変色のない事。
			Should not have any flaw, scratch,
			discoloration, and crushed.

5-9 機械的性性

5-2. Functional Performance

	3 — 4. 7成770月17日1	± 5-2. Functional Pe	riormance
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	端子の保持力	端子に25mm/分の速度で加重を加え、端子がハウジングより	1.0N 以上
	Contact retention	抜け始めたときの荷重を測定する。	
	force	The contact shall be pulled at the speed of 25mm per minute and	1.0N or more
		measured the force when the contact begins to remove from the	
		housing.	
2	挿抜耐久性	FFC を 20 回繰返し挿抜を行ない接触抵抗を測定する。	80mΩ以下
	Insertion	The FFC shall be mated and unmated 20 times and measured	
	/Extraction	the contact resistance.	80mΩ or below
	endurance		
3	衝撃試験	FFC を嵌合した状態にて治具に取り付け、加速度 980m/s²、	試験中1μs以上の瞬断の無き事。
	Shock test	衝撃作用時間 6ms を X,Y,Z,方向の 6 面に各 1 0 回加え、試験中の	80mΩ以下
		瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated are installed in the machine. They are	Discontinuity: $1 \mu s$ or less.
		applied pulses 10 times to each 6 faces of 3 mutually perpendicular	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below .
		directions(X,Y,Z); under conditions as specified; acceleration of	Should not have any damages
		980m/s ² and shock pulses for a duration of 6ms. It shall be tested the	
		discontinuity of the contact current during the test and measured the	
L		contact resistance and observed its appearance after the test.	

No.	IS-11501-006	来歴	Ô	頁	2/8

4	振動試験	FFC を嵌合した状態にて、振動周波数 10~500~10Hz、	試験中1μs以上の瞬断の無き事。
	Vibration test	掃引時間12分、振幅1.5mm、又は加速度98m/s2のいずれか小さい方	80mΩ以下
		にて X 軸方向に4時間、Y Z 軸方向に各2時間計8時間の振動を加え	外観:異常なきこと
		る。試験中、瞬断の有無の確認、試験後の接触抵抗の測定及び外観観察	Discontinuity: 1μ s or less.
		をする。	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		The connector and FFC mated is vibrated in the frequency range of $10\sim500\sim10$ Hz/12min and in the constant vibration amplitude	Should not have any damages
		1.5mm or the acceleration of 98m/s². The amplitude or the	
		acceleration above shall be chosen either one under which the	
		connectors is loaded more slightly. And this motion is applied for	
		period of 4hours in one of 3 mutually perpendicular	
		directions(X-axis), and 2hours in other two of them(Y and Z-axis). It	\
		shall be tested the discontinuity of the contact current during the test	
		and measured the contact resistance and observed its appearance after the test.	
5	FFC 挿抜力		接3 + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ð	FFC f甲f及力 FFC Insertion	コネクタと FFC を 25mm/分の速度で挿入を行い、この時の荷重を測	挿入力: 0.625N/極 以下
	/Extraction force	定する。(初回)	Insertion force: 0.625N/ckt or below
	/Extraction force	The connector and FFC shall be mated at the	
		the speed of 25mm per minute and measured the force of insertion. (First time)	
6	FFC 保持力	FFC に 25mm/分の速度で加重を加え、FFC がハウジングより	0.29N/極 以上
	FFC	抜け始めたときの荷重を測定する。	
	retention force	The FFC shall be pulled at the speed of 25mm per minute and	0.29N/ckt or more
		measured the force when the FFC begins to remove from the	
		housing.	

5-3. 環境特件

5-3. Environmental performance

	<u>5 – 3.環境特性</u>	5-3.Environmental performance	
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	耐熱性	FFC を嵌合した状態にて温度 105±2℃の恒温槽に 1000 時間放置し、	80mΩ以下
	Heat resistance	試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		105 ± 2 °C for 1000 hours. It shall be measured the contact resistance	Should not have any damages
		and observed its appearance after the test.	1
2	耐寒性	FFC を嵌合した状態にて温度-40±3℃の低温槽に 1000 時間放置し、試	80mΩ以下
	Chilly resistance	験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the chilly chamber	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below .
		$-40\pm3\%$ for 1000 hours. It shall be measured the contact resistance	Should not have any damages
		and observed its appearance after the test.	
3	耐湿性	FFC を嵌合した状態にて温度 85±2℃、相対湿度 85%の恒温	80mΩ以下
	Humidity	恒湿槽に 1000 時間放置し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the heat chamber	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		$85\pm2\%$,85%RH for 1000 hours. It shall be measured the	Should not have any damages
		contact resistance and observed its appearance after the test.	
4	H2Sガス試験	FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度	80mΩ以下
	H ₂ S gas test	3±1ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the H ₂ S gas	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below .
		chamber 40 ± 2 °C,75% RH 3 ± 1 ppm for 96 hours.	Should not have any damages
		It shall be measured the contact resistance after the test.	
5	SO ₂ ガス試験	FFC を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度	80mΩ以下
	SO ₂ gas test	10±3ppm の雰囲気中に 96 時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the SO ₂	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		gas chamber $40\pm2\%,75\%$ RH 10 ± 3 ppm for 96 hours.	Should not have any damages
		It shall be measured the contact resistance after the test.	
6	塩水噴霧試験	FFC を嵌合した状態にて、温度 35±2℃、濃度 5±1%の	80mΩ以下
	Salt spray test	塩水噴霧中に48時間放置し、試験後接触抵抗を測定する。	外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed in the salt	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below .
		spray chamber $35\pm2\%$, $5\pm1\%$ salt density for 48 hours.	Should not have any damages
		It shall be measured the contact resistance after the test.	

No.	IS-11501-006	来歷	0	頁	3/8
1.0.	1001 000	7,011.	1 ()	_ ^<	0,0

	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
7	冷熱衝撃試験	FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして	80mΩ以下
	Thermal shock test		外観:異常なきこと
		The connector and FFC mated is exposed 1000 cycles under the	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below.
		following temperature conditions. It shall be measured the contact	Should not have any damages
1		resistance and observed its appearance after the test.	
		+105±2℃	
		常温 Ambient	:
		temperature 30min	
		-40±3℃	
		1 cycle	
8	温湿度	FFC を嵌合した状態にて下図の温度条件を1サイクルとして	80mΩ以下
	サイクル試験	10 サイクル実施し、試験後接触抵抗測定及び外観観察を行う。	外観:異常なきこと
	Humidity	The connector and FFC mated is exposed 10 cycles under the	$80 \mathrm{m}\Omega$ or below .
	resistance	following temperature conditions. It shall be measured the contact	Should not have any damages
		resistance and observed its appearance after the test.	
		+80±2°C	
		95%RH	
		-20±3°C	
	,	$\leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \leftarrow 2h \rightarrow \rightarrow$	
		1cycle	

	5-4. その他の性	能 5-4.Other specification	l
	項目/Item	条件/Test condition	規格/Specification
1	半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー半田槽に 3±0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath (Type of Sn-Ag-Cu) 245±5℃,3±0.5s.	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく付着する事。 Solder shall cover 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性 Soldering heat test	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat under the following conditions. 条件①: リフローの場合 (2回) /In case of reflow (2times) 250℃MAX.(ピーウ温度)、10sMAX. (Peak temperature) 30~60s 230℃MIN. (予熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to 180℃) 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. (2)手半田 の場合/ In case of manual soldering. 半田鏝温度 / temperature : 350±5℃ 浸漬時間 / time : 3±0.5s 但し、ピンに異常加圧無き事。 /However, excessive pressure shall not be applied to the terminal.	実使用上、問題無き事。 Should not have any problems.
3	温度上昇試験	最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度上昇を測定する。	温度上昇:30℃以下
	Rise of	The connector shall be operated in the maximum rise of current and	Rise of temperature:
	temperature test	measured rise of the temperature at contact point.	30°C or below

No. IS-11501-006 来歴 🛭 🛛 頁 4/8

6.その他

- ・改良等によりひけ逃げを追加する事がありますので、ご了承願います。
- ・和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を 優先致します。
- ・本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが 発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する 保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

7.故障率

MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて 算出を行う。(単位: FIT)

6. Others

Please acknowledge adding shape to lose sink by the improvement etc.

When difference is found between Japanese Specifications and English Specifications, priority shall be given to Japanese.

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

7.Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit: FIT)

極数/ckt	故障率/Failure rate
20	2.03
25	2.42
30	2.84
35	3.28
40	3.76
45	4.27
50	4.82
55	5.40
60	6.03

8. 製品の保管期間

9.保管条件

温度 $-10\sim+40$ $^{\circ}$ 、湿度 75%RH 以下の相対湿度で保管してください。

8. Term of a guarantee

1 year from delivery date.

9.Storage condition

Shall be storage in the house at -10~+40°C,75%RH MAX.

FPC/FFC 用コネクタ

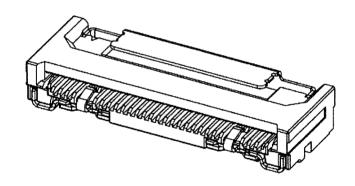
Connector for FPC/FFC

取り扱い説明書

Manual

適用製品:11501 シリーズ

Application product: series 11501



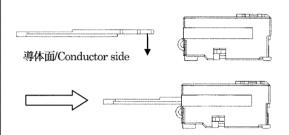
使用上の注意点

操作方法

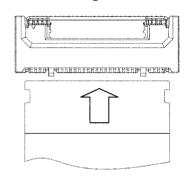
FPC/FFC 挿入方法 FPC/FFC insertion

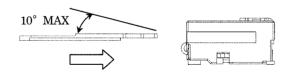
① FPC/FFC は導体面を下にして挿入してください。 その際 FPC/FFC はコネクタに対し垂直に挿入口へ奥に 突き当たるまでしっかり挿入してください。

Fully insert the FPC/FFC parallel to mounting surface, with the exposed conductive traces facing DOWN.



②FPC/FFC はコジらず、真直ぐ挿入してください。 Please insert FPC/FFC straight.



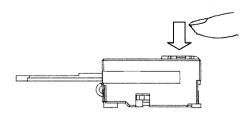


FPC/FF

C 抜去方法 FPC/FFC removal

①上面の解除レバーを押しながら、FFC/FPC を 引き抜いてください。

While holding down the top of the release lever, the FFC / FPC pull out.

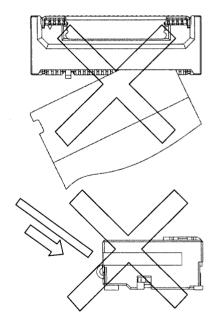


斜めに挿入したり、こじって挿入しますと、半嵌合又は、接点への ダメージの原因となり、接触不良が発生する恐れがございます。

The terminal transformation happens when FPC/FFC is diagonally

And, the loose connection happens.

inserted.



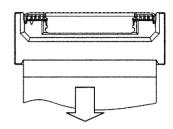
解除レバーを押さずに FFC/FPC を引き抜きますと、コネクタもしくは FFC/FPC が破損する可能性がございます。

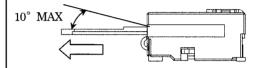
When you pull the FFC / FPC without pressing the release lever, connector or FFC / FPC will be damaged.

解除レバーは軽い力で押し下がりますので、強い力を加えないでください。(10N以下)

Release lever is not pressed strongly.(10N MAX.)

②FFC/FPC はコジらず、真直ぐ引き抜いてください。 Please pull out FPC/FFC straight.

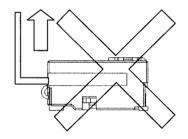




FPC/FFC 嵌合状態 FPC/FFC mating

①FFC/FPC 嵌合状態で上方向にテンションが掛からないようにしてください。

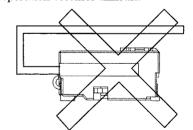
The force of FFC / FPC is to not placed on the top.



②FFC/FPC の引き回しがコネクタ上面に来ないようにしてください。

解除レバー操作が困難になります。

 $\ensuremath{\mathsf{FFC}}\xspace$ / $\ensuremath{\mathsf{FPC}}$ is to avoid incurring the connector top. Release lever operation becomes difficult.



No. IS-11501-006 来歴 () 頁 8/8

その他 Others

①コネクタ実装後、半田接合部が変色する場合がございますが 使用上問題ございません。

There is no problem in use though the solder joint part might discolor after mounting the connector.

②モールド内に黒点が発生する場合がございますが、性能上 問題ございません。

There is no problem on the performance though the black spot might be generated in molding.

③異種金属嵌合は、行わないでください。 Please do not do the different kind metal mating.

④カード挿入口前に、カードの姿勢が変わるような部品を 配置しないでください。

Please do not arrange parts into which the posture of the card changes in the card insertion entrance front.

⑤反転リフロー時に製品が落下する可能性がございますので テープ等で補強することを推奨致します。

Since a product may fall at the time of reversal reflow, I recommend reinforcing on a tape etc.

⑥FFC/FPC を挿抜する際は、補強板を持って行ってください。 FFC / FPC to operate with a reinforcing plate.

⑦活線挿抜は行わないでください。 Please do not hot-swap.